

FDY300NZ

Single N-Channel 2.5V Specified PowerTrench® MOSFET

General Description

This Single N-Channel MOSFET has been designed using Fairchild Semiconductor's advanced PowerTrench process to optimize the $R_{DS(ON)}$ @ $V_{GS} = 2.5V$.

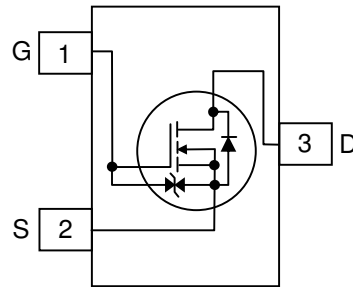
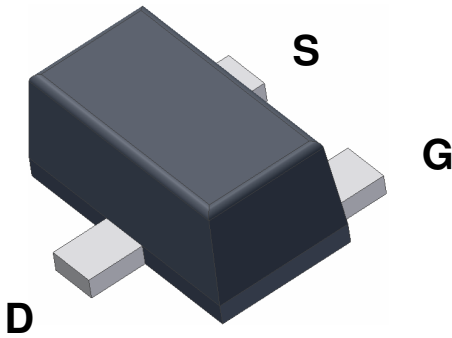
Applications

- Li-Ion Battery Pack



Features

- 600 mA, 20 V $R_{DS(ON)} = 700\text{ m}\Omega$ @ $V_{GS} = 4.5\text{ V}$
 $R_{DS(ON)} = 850\text{ m}\Omega$ @ $V_{GS} = 2.5\text{ V}$
- ESD protection diode (note 3)
- RoHS Compliant



Absolute Maximum Ratings T_A=25°C unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Ratings	Units
V_{DSS}	Drain-Source Voltage	20	V
V_{GSS}	Gate-Source Voltage	± 12	V
I_D	Drain Current – Continuous (Note 1a)	a) 600	mA
		1000	
P_D	Power Dissipation (Steady State) (Note 1a) (Note 1b)	a) 625	mW
		446	
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Junction Temperature Range	-55 to +150	°C

Thermal Characteristics

$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance, Junction-to-Ambient (Note 1a)	a) 200	°C/W
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance, Junction-to-Ambient (Note 1b)	280	

Package Marking and Ordering Information

Device Marking	Device	Reel Size	Tape width	Quantity
C	FDY300NZ	7"	8 mm	3000 units

Electrical Characteristics

$T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
--------	-----------	-----------------	-----	-----	-----	-------

Off Characteristics

BV_{DSS}	Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{GS} = 0\text{ V}, I_D = 250\ \mu\text{A}$	20			V
$\frac{\Delta BV_{DSS}}{\Delta T_J}$	Breakdown Voltage Temperature Coefficient	$I_D = 250\ \mu\text{A}$, Referenced to 25°C		15		$\text{mV}/^\circ\text{C}$
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{DS} = 16\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$			1	μA
I_{GSS}	Gate-Body Leakage,	$V_{GS} = \pm 12\text{ V}, V_{DS} = 0\text{ V}$			± 10	μA
		$V_{GS} = \pm 4.5\text{ V}, V_{DS} = 0\text{ V}$			± 1	μA

On Characteristics (Note 2)

$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\ \mu\text{A}$	0.6	1.0	1.3	V
$\frac{\Delta V_{GS(th)}}{\Delta T_J}$	Gate Threshold Voltage Temperature Coefficient	$I_D = 250\ \mu\text{A}$, Referenced to 25°C		3		$\text{mV}/^\circ\text{C}$
$R_{DS(on)}$	Static Drain-Source On-Resistance	$V_{GS} = 4.5\text{ V}, I_D = 600\text{ mA}$ $V_{GS} = 2.5\text{ V}, I_D = 500\text{ mA}$ $V_{GS} = 1.8\text{ V}, I_D = 150\text{ mA}$ $V_{GS} = 4.5\text{ V}, I_D = 600\text{ mA}, T_J = 125^\circ\text{C}$		0.24 0.36 0.70 0.35	0.70 0.85 1.25 1.00	Ω
g_{FS}	Forward Transconductance	$V_{DS} = 5\text{ V}, I_D = 600\text{ mA}$		1.8		S

Dynamic Characteristics

C_{iss}	Input Capacitance	$V_{DS} = 10\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V},$ $f = 1.0\text{ MHz}$		60		pF
C_{oss}	Output Capacitance			20		pF
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance			10		pF

Switching Characteristics (Note 2)

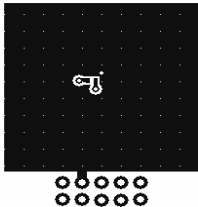
$t_{d(on)}$	Turn-On Delay Time	$V_{DD} = 10\text{ V}, I_D = 1\text{ A},$ $V_{GS} = 4.5\text{ V}, R_{GEN} = 6\ \Omega$		6	12	ns
t_r	Turn-On Rise Time			8	16	ns
$t_{d(off)}$	Turn-Off Delay Time			8	16	ns
t_f	Turn-Off Fall Time			2.4	4.8	ns
Q_g	Total Gate Charge	$V_{DS} = 10\text{ V}, I_D = 600\text{ mA},$ $V_{GS} = 4.5\text{ V}$		0.8	1.1	nC
Q_{gs}	Gate-Source Charge			0.16		nC
Q_{gd}	Gate-Drain Charge			0.26		nC

Drain-Source Diode Characteristics and Maximum Ratings

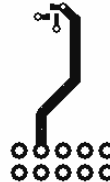
V_{SD}	Drain-Source Diode Forward Voltage	$V_{GS} = 0\text{ V}, I_S = 150\text{ mA}$ (Note 2)		0.7	1.2	V
t_{rr}	Diode Reverse Recovery Time	$I_F = 600\text{ mA},$		8		nS
Q_{rr}	Diode Reverse Recovery Charge	$di_F/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$		1		nC

Notes:

- $R_{\theta JA}$ is the sum of the junction-to-case and case-to-ambient thermal resistance where the case thermal reference is defined as the solder mounting surface of the drain pins. $R_{\theta JC}$ is guaranteed by design while $R_{\theta CA}$ is determined by the user's board design.



- a) $200^\circ\text{C}/\text{W}$ when mounted on a 1 in^2 pad of 2 oz copper



- b) $280^\circ\text{C}/\text{W}$ when mounted on a minimum pad of 2 oz copper
Scale 1 : 1 on letter size paper

- Pulse Test: Pulse Width < $300\ \mu\text{s}$, Duty Cycle < 2.0%
- The diode connected between the gate and source serves only as protection against ESD. No gate overvoltage rating is implied.

Typical Characteristics

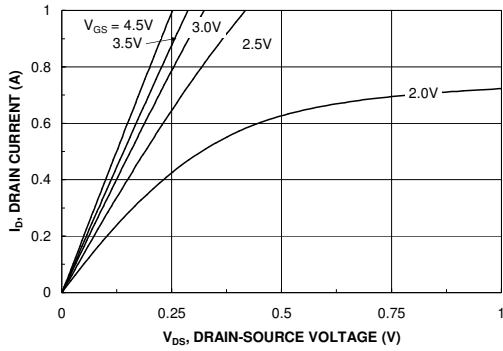


Figure 1. On-Region Characteristics.

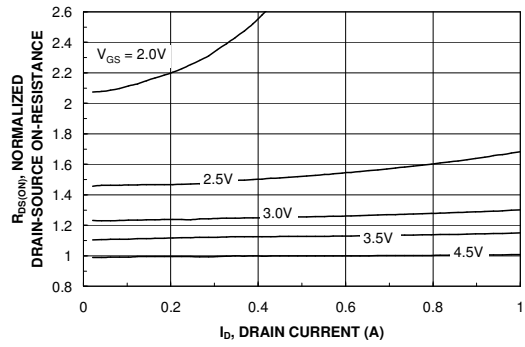


Figure 2. On-Resistance Variation with Drain Current and Gate Voltage.

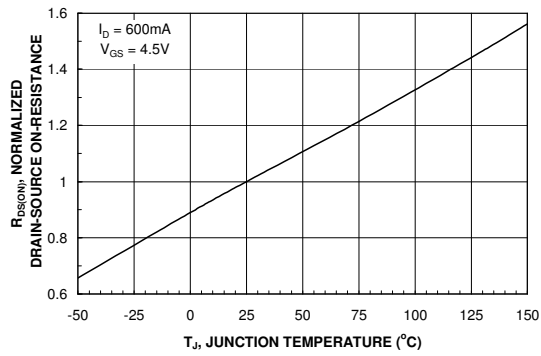


Figure 3. On-Resistance Variation with Temperature.

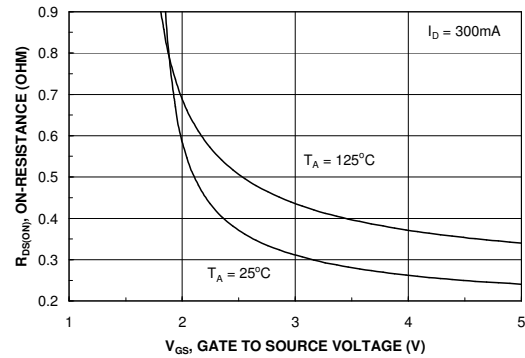


Figure 4. On-Resistance Variation with Gate-to-Source Voltage.

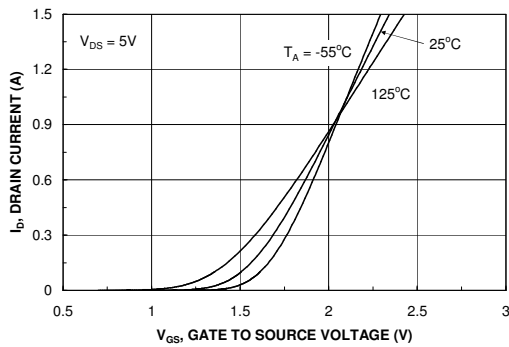


Figure 5. Transfer Characteristics.

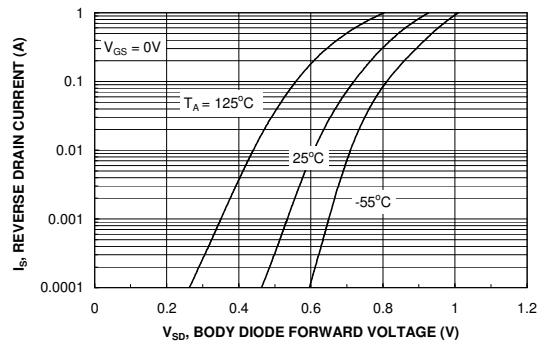


Figure 6. Body Diode Forward Voltage Variation with Source Current and Temperature.

Typical Characteristics

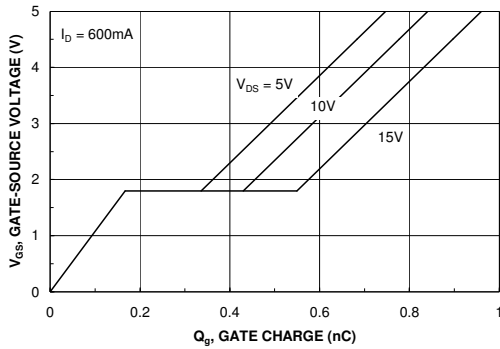


Figure 7. Gate Charge Characteristics.

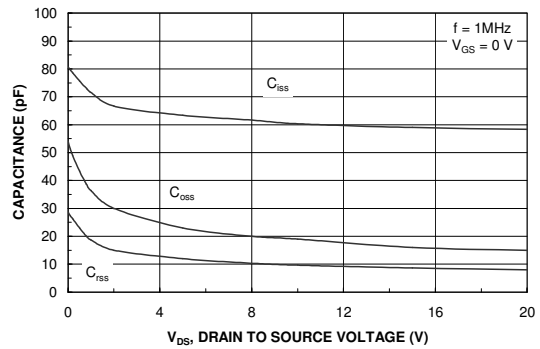


Figure 8. Capacitance Characteristics.

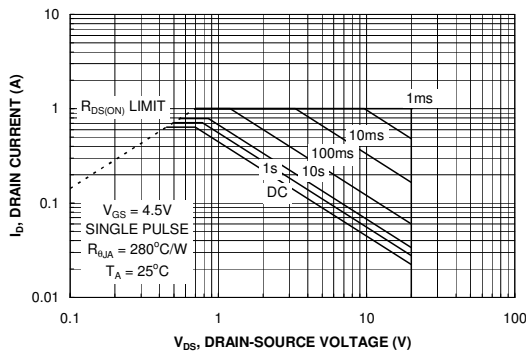


Figure 9. Maximum Safe Operating Area.

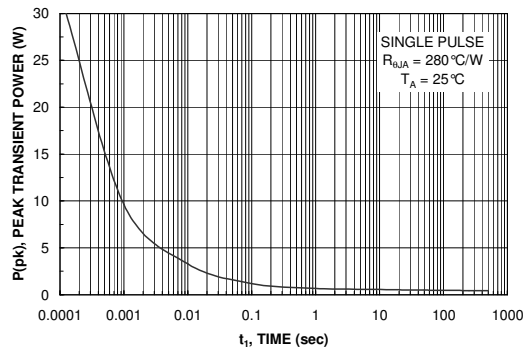


Figure 10. Single Pulse Maximum Power Dissipation.

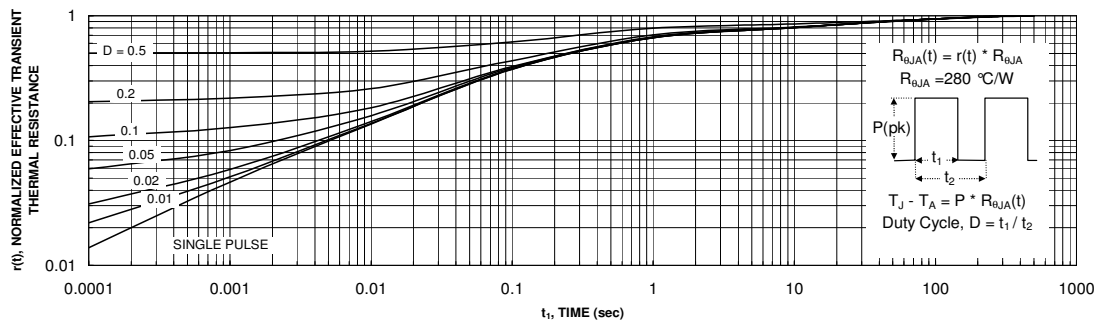
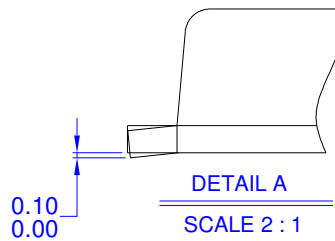
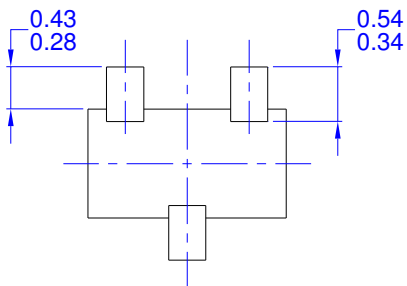
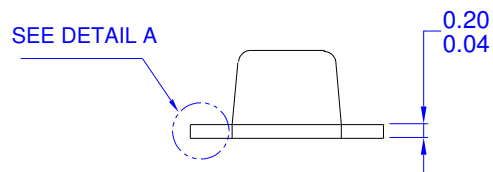
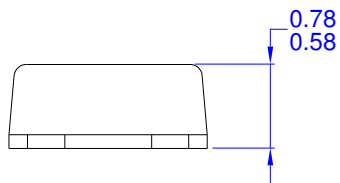
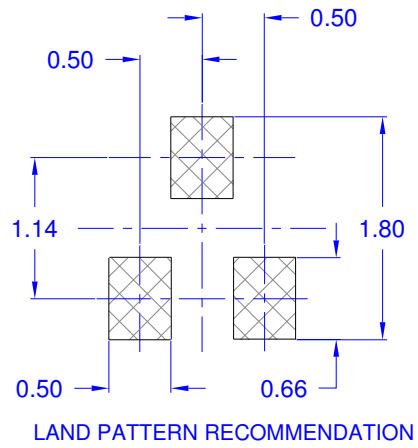
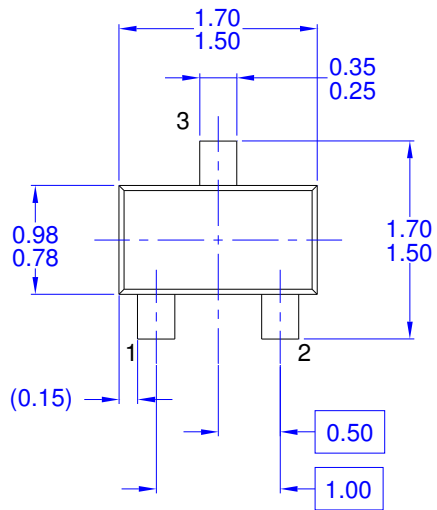


Figure 11. Transient Thermal Response Curve.

Thermal characterization performed using the conditions described in Note 1b. Transient thermal response will change depending on the circuit board design.

Dimensional Outline and Pad Layout



- NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
- A) THIS PACKAGE CONFORMS TO EIAJ SC89 PACKAGING STANDARD.
 - B) ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
 - C) DIMENSIONS ARE EXCLUSIVE OF BURRS, MOLD FLASH, AND TIE BAR EXTRUSIONS.

TRADEMARKS

The following are registered and unregistered trademarks Fairchild Semiconductor owns or is authorized to use and is not intended to be an exhaustive list of all such trademarks.

ACEx™	FACT Quiet Series™	OCX™	SILENT SWITCHER®	UniFET™
ActiveArray™	GlobalOptoisolator™	OCXPro™	SMART START™	VCX™
Bottomless™	GTO™	OPTOLOGIC®	SPM™	Wire™
Build it Now™	HiSeC™	OPTOPLANAR™	Stealth™	
CoolFET™	I ² C™	PACMAN™	SuperFET™	
CROSSVOLT™	<i>i-Lo</i> ™	POP™	SuperSOT™-3	
DOMET™	ImpliedDisconnect™	Power247™	SuperSOT™-6	
EcoSPARK™	IntelliMAX™	PowerEdge™	SuperSOT™-8	
E ² CMOS™	ISOPLANAR™	PowerSaver™	SyncFET™	
EnSigna™	LittleFET™	PowerTrench®	TCM™	
FACT®	MICROCOUPLER™	QFET®	TinyBoost™	
FAST®	MicroFET™	QS™	TinyBuck™	
FASTr™	MicroPak™	QT Optoelectronics™	TinyPWM™	
FPS™	MICROWIRE™	Quiet Series™	TinyPower™	
FRFET™	MSX™	RapidConfigure™	TinyLogic®	
	MSXPro™	RapidConnect™	TINYOPTO™	
Across the board. Around the world.™		µSerDes™	TruTranslation™	
The Power Franchise®		ScalarPump™	UHC®	
Programmable Active Droop™				

DISCLAIMER

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT FURTHER NOTICE TO ANY PRODUCTS HEREIN TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN. FAIRCHILD DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF THE APPLICATION OR USE OF ANY PRODUCT OR CIRCUIT DESCRIBED HEREIN; NEITHER DOES IT CONVEY ANY LICENSE UNDER ITS PATENT RIGHTS, NOR THE RIGHTS OF OTHERS. THESE SPECIFICATIONS DO NOT EXPAND THE TERMS OF FAIRCHILD'S WORLDWIDE TERMS AND CONDITIONS, SPECIFICALLY THE WARRANTY THEREIN, WHICH COVERS THESE PRODUCTS.

LIFE SUPPORT POLICY

FAIRCHILD'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORPORATION.

As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or systems which, (a) are intended for surgical implant into the body, or (b) support or sustain life, or (c) whose failure to perform when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in significant injury to the user.
2. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

PRODUCT STATUS DEFINITIONS

Definition of Terms

Datasheet Identification	Product Status	Definition
Advance Information	Formative or In Design	This datasheet contains the design specifications for product development. Specifications may change in any manner without notice.
Preliminary	First Production	This datasheet contains preliminary data, and supplementary data will be published at a later date. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design.
No Identification Needed	Full Production	This datasheet contains final specifications. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design.
Obsolete	Not In Production	This datasheet contains specifications on a product that has been discontinued by Fairchild semiconductor. The datasheet is printed for reference information only.

Rev. I22



Поставка электронных компонентов

Юридический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
Фактический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
ИНН 780277764
КПП 780501001
Р/С 40702810422510004035 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703
БИК 044030703
Телефон: 8 (812) 309-44-11 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 309-44-11
Электронная почта: sales@timechips.ru
Сайт: timechips.ru

Информационное письмо

Компания «ТаймЧипс» - одна из наиболее динамично развивающихся компаний в сфере поставок электронных компонентов. Мы поставляем широкую номенклатуру электронных компонентов отечественных и импортных производителей, как напрямую, так и с крупных мировых складов, позволяющих охватить выборочную номенклатуру более 300 брендов, а также специализируемся на поставках дисплеев и является официальным дистрибьютором компании Shenzhen Startek Electronic Technology Co, на территории Российской Федерации.

Наличие собственной логистики позволяет в кратчайшие сроки доставлять товар нашим клиентам. В нашей компании имеется Конструкторский отдел, где наши специалисты проводят технические консультации клиентов, квалифицированную поддержку и помощь российским разработчикам. Осуществляем Поставки импортной продукции под контролем ВП МО РФ, на предприятия Оборонно-промышленного комплекса России. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

Благодаря нацеленности на результат, мы уверенно занимаем новые позиции на рынке, заинтересовывая Клиента не только актуальными ценами и гибким подходом, но и постоянным вниманием.

Миссия – обеспечение долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с клиентами.

Наша цель – Обеспечение клиентам самого широкого ассортимента электронных компонентов и бесперебойности поставок.

Мы - это развитие! Мы задаем темп! Мы разные, но вместе! Мы работаем для вас!

Так же имеем прямые поставки от производителей:

TAI-SAW Пав-компоненты (www.taisaw.com)

TRANSCOM СВЧ-компоненты (www.transcominc.com.tw)

Mini Circuits ВЧ-СВЧ-компоненты (minicircuits.com)

SAMTEC- разъемы (www.samtec.com)

4Star Разъемы РЧ (Даташиты по продукции 4Star, которые Вы сможете загрузить по этой ссылке: <https://yadi.sk/i/tPjnmGGrpmbYj>)

ULNION Преобразователи напряжения (converterdc.com/)

Отличные рекомендации на рынке, уверенность в качестве поставляемой продукции делают нас надежными партнерами для наших клиентов.

«ТаймЧипс» - это:

- Гарантия качества поставляемой продукции;
- Широкий ассортимент;
- Минимальные сроки поставок;
- Техническая поддержка;
- Подбор комплектации;
- Индивидуальный подход;
- Гибкие цены.

Модули, микросхемы, пассивные компоненты, Xilinx (XC), Altera (EP,EPF, EPM) и силовая электроника – это наши ведущие позиции, на поставку которых мы гарантированно дадим Вам самые выгодные предложения!

В структуру компании так же входит конструкторский отдел, который помогает разработчикам и конструкторам в решении следующих задач:

- Оценка стоимости проекта по компонентам;
- Подбор оптимального решения при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Техническая поддержка;
- Консультации у производителей;
- Поставка прототипов;

С Уважением, Чернов Павел.

Руководитель отдела продаж ООО "ТАЙМЧИПС"

Официальный дистрибьютор Shenzhen Startek Electronic Technology Co.,Ltd в России (USB Display Modules , LED Displays, Serial Modules).

<http://www.timechips.ru/>

<http://lcd-timechips.ru/>

Телефон: +7 (812) 309-44-11 доб. 141

Факс: +7 (812) 309-44-11 доб. 152

Моб. Тел. +7 (905) 232-40-65

Skype: time.chips5

Электронная почта: manager1@timechips.ru
